

ANALISIS PRODUK CACAT PCB KAMERA MENGGUNAKAN PETA KENDALI “P” DI PT.XYZ

Medina Putri Aulia

Abstrak

PCB adalah serangkaian komponen yang ada di dalam kamera. singkatan dari PCB adalah Printed Circuit Board yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi Papan Rangkaian Cetak atau Papan Sirkuit Cetak ,yaitu salah satu produk yang dihasilkan PT.XYZ. Dalam hasil produksi PCB , PT.XYZ memiliki jumlah defect 39500 unit . Oleh karena itu masalah yang diteliti adalah tingkat kecacatan PCB, penyebab cacat dan perbaikan yang harus dilakukan di PT.XYZ.Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitas PCB.Obyek penelitian adalah cacat PCB dengan metode Statistical proses control. Instrumen penelitian berupa interview,observasi,dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan, defect . Jika dilihat dari total cacat menurut jenisnya : Low Solder (43.15 %) , Shifted (23.26%) , Body Standing (17.08%) , Part Missing (11.10%) ,Solder Touch (5.04%) dari total produk cacat. Penelitian ini mengambil presentase penyebab cacat paling besar yaitu Low Solder .Penyebab terjadinya cacat yaitu kurangnya pastal solder , karena setingan pendorong yang begitu cepat dan mengakibatkan kurangnya solder pada PCB untuk material . Perbaikan menggunakan 5W+1h dengan hasil yaitu dibuatkan standar waktu yang pas pada proses perakitan agar menghasilkan output yang stabil.

Kata Kunci : Statistical Proses Control,5w+1hDefect,

Analysis of a defective product pcb camera using a map control “p” in pt.xyz

Medina Putri Aulia

abstract

PCB is a series of components in the camera. stands for PCB is Printed Circuit Board which in Indonesian is often translated into Printed Circuit Board or Print Circuit Board, which is one of the products produced by PT.XYZ. In the PCB production, PT.XYZ has 39500 units of defects. Therefore the problem studied is the PCB disability rate, the cause of defects and improvements that must be done in PT.XYZ. Penelitian is a research quality PCB analysis. Object research is a defect PCB with Statistical process control method. The research instruments are interview, observation, and documentation. The results of this study show, defect. When viewed from total defects by type: Low Solder (43.15%), Shifted (23.26%), Body Standing (17.08%), Part Missing (11.10%), Solder Touch (5.04%) of total defective products. This research takes the biggest defect percentage that is Low Solder. The cause of the defect is the lack of paste solder, because the pusher is so fast and cause the lack of solder on PCB for material. Improvements using 5W + 1h with the result that is made a standard time that fits on the assembly process to produce a stable output.

Keyword :Statistical Proses Control,5w+1h Defect,